

东信和平智能卡股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1047 号文核准,公司获准以总股本 153,452,000 股为基数,按照每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售不超过 46,035,600 股的人民币普通股(A 股)。本次配股采取向截至 2009 年 12 月 4 日登记在册的全体股东网上定价方式发行。根据网上总体认购情况,最终发行数量为 45,110,504 股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价为人民币 4.6 元,可募集资金 207,508,318.40 元,扣除相关发行费用 9,145,110.50 元、加上募集资金利息 12,306.96 元后,实际募集资金净额为 198,375,514.86 元。上述募集资金已于 2009 年 12 月 15 日全部到位,业经天健会计师事务所有限公司浙天验字[2009]第 253 号《验资报告》验证。

2009 年度,公司募集资金实际使用金额为 23,923,362.83 元,募集资金余额为 174,452,152.03 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定,公司制定了《东信和平智能卡股份有限公司募集资金管理与使用办法》。

(二) 募集资金管理制度的执行情况及专项存储情况

根据《东信和平智能卡股份有限公司募集资金管理与使用办法》,公司对募集资金实行专项存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。

公司已与保荐人信达证券股份有限公司、交通银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2009 年 12 月 31 日止,公司募集资金在交通银行珠海分行专户存款余额为

176,791,269.51 元,具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存款余额
交通银行股份有限公司珠海分行	444000091018001006820	募集资金专户	176,791,269.51
合 计			176,791,269.51

(三) 募集资金专户存款余额与募集资金实际余额差异说明

截至 2009 年 12 月 31 日止,公司募集资金专户存款余额比募集资金实际余额多 2,339,117.48 元。其差异原因为: 应付未付审计费、律师费和信息费等发行费用 2,300,000.00 元; 募集资金专户存款利息 39,117.48 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金项目情况

1、配股说明书承诺的募集资金运用计划

公司配股说明书承诺的募集资金投资项目、计划投资金额和预计收益如下:

(单位:人民币万元)

配股说明书承诺投资项目	配股说明书承诺投资总金额	配股说明书计划投资金额			配股说明书承诺建设期	预计年收益
		2008 年	2009 年	2010 年		
智能卡生产线 (II 期) 技改项目	7,909	2,482	5,427		24 个月	1,480
东信和平智能卡 (孟加拉国) 有限公司项目	350 万美元 (折合 2,450 万元人民币)	2,450			18 个月	129 万美元 (折合 903 万元人民币)
IC 模块封装技术引进及产业化项目	9,913	670	7,243	2,000	14 个月	
合 计	20,272	5,602	12,670	2,000		

(1) 智能卡生产线 (II 期) 技改项目

公司配股说明书承诺投资 7,909.00 万元进行智能卡生产线 (II 期) 技改,该项目已经广东省经济贸易委员会备案,备案项目编号 07040240531001640。项目建设期为 24 个月,项目建成达产后,可年新增利润总额 1,480 万元。

(2) 东信和平智能卡 (孟加拉国) 有限公司项目

公司配股说明书承诺投资 350 万美元 (折合 2,450 万元人民币) 实施东信和平智能卡 (孟加拉国) 有限公司项目,该项目经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸合函 [2008]172 号核准,项目的总投资为 350 万美元 (折合 2,450 万元人民币),项目建设

期为 18 个月。项目建成达产后,可实现税后利润 129 万美元。

(3) IC 模块封装技术引进及产业化项目

公司配股说明书承诺投资 9,913 万元初实施 IC 模块封装技术引进及产业化项目。本项目已经珠海市发展和改革委员会备案(备案项目编号 070402406110251),项目总投资概算为 9,913 万元,项目建设期为 14 个月,项目建成达产后,可实现税后利润 1,912 万元。

2、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金项目实际投资金额、占计划投资额的比例、完工程度和实现的收益如下:

(单位:人民币万元)

实际投资项目	累计实际投资金额	本年度投资金额	实际投资额占计划投资额的比例	完工程度	本年实现的收益	截止2009年底累计实现的收益
智能卡生产线(II期)技改项目	1673	889	21.15%	21.15%	798.48	2,114.90
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司项目	350 万美元 (折合 2392 万元人民币)	350 万美元 (折合 2392 万元人民币)	100%	100.00%	30 万美元(折合 207 万元人民币)	30 万美元(折合 207 万元人民币)
IC 模块封装技术引进及产业化项目	0	0			0	0
合计	4065	3281				2,321.90

3、募集资金实际使用情况与本公司配股说明书承诺投资内容对照情况如下:

(1) 智能卡生产线(II期)技改项目

截至 2009 年 12 月 31 日止,智能卡生产线(II期)技改项目尚未投入募集资金。公司已用银行贷款先期投入该项目 1673 万元,2008 年度该项目实现利润 1,316.42 万元,占配股说明书承诺收益的 88.95%,2009 年度该项目实现的利润总额为 798.48 万元,占配股说明书承诺收益的 53.95%,主要系募集资金到位前,为控制项目实施风险,公司放缓项目实施进度,未达到预期收益。

(2) 东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司项目

截至 2009 年 12 月 31 日止,东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司项目实际投入募集资金 2,392.00 万元,该项目 2009 年度已全部完工;本年度实现税后利润为 30 万美元,占配股说明书承诺收益的 23.25%,主要系该项目于 2009 年 6 月开始投入生产,未达到预期收益。

(3) IC 模块封装技术引进及产业化项目

截至 2009 年 12 月 31 日止， IC 模块封装技术引进及产业化项目尚未投入募集资金。

(二) 变更募集资金项目的资金使用情况

本年度未变更募集资金项目。

(三) 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

本年度未发生募集资金项目的实施方式、地点变更情况。

(四) 募集资金项目先期投入及弥补情况

募集资金项目智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目已使用银行贷款先期投入 1673 万元，本年度尚未用募集资金弥补；东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目已使用银行贷款先期投入 350 万美元（折合人民币 2,392.00 万元），本年度已用募集资金进行了弥补；本公司已用自有资金支付审计费、律师费和信息费等其他发行费用 230 万元，本年度尚未用募集资金款弥补。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(六) 募集资金其他使用情况

不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款和用募集资金存单质押取得贷款等其他使用情况。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会

二零一零年三月三日